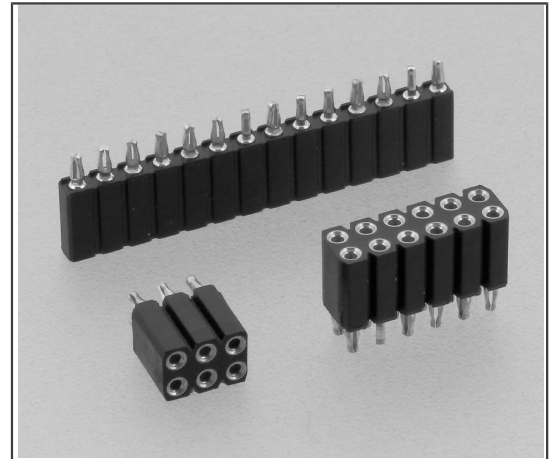


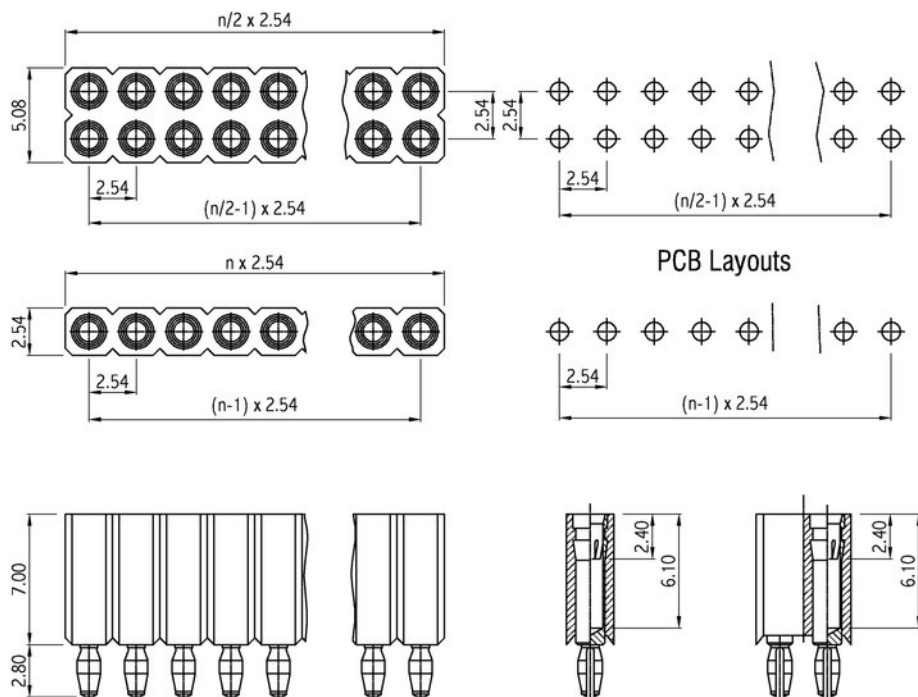
Press-Fit Präz.-Buchsenleisten RM 2,54mm, 1-/2-reihig **Press-Fit Precision Female Headers, 2.54mm Pitch, Single/Double Row**

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Hülse: Phosphorbronze gedreht
	Feder: 6-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	Sleeve: screw machined phosphor bronze
	Clip: 6-Finger-Clip, Beryllium-Copper
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	< 10 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Test Voltage	1 kV RMS
Nennstrom	3 A
Current Rating	3 A
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	-55 °C ... +125 °C



Einsetzbar für Rundstifte Ø0,65-0,85mm oder Vierkantstifte 0,635mm. Auf Anfrage für Rundstifte Ø0,40-0,56mm oder Vierkantstifte 0,40x0,25mm erhältlich.
Accept round pins Ø0.65-0.85mm or 0.635mm square pins.
Also available on request for Ø0.40-0.56mm round pins or 0.40x0.25mm rectangular pins.



Einpresszone s. Tech. Informationen.
See technical Information for PressFit zones.

Series

Contacts*

Rows*

Sleeve Plating

Clip Plating*

TC-0306PF
010
1
50
00

002-050 Einreihig
Single row
004-100 Zweireihig
Double row

1 Einreihig
Single row
2 Zweireihig
Double row

50 Hülse verzinnt
Tin plated sleeve

00 Feder vergoldet
Gold plated clip
10 Feder 0,25µm Gold (Option)
0.25µm gold plated clip (Option)
30 Feder 0,75µm Gold
0.75µm gold plated clip
50 Feder verzinnt
Tin plated clip

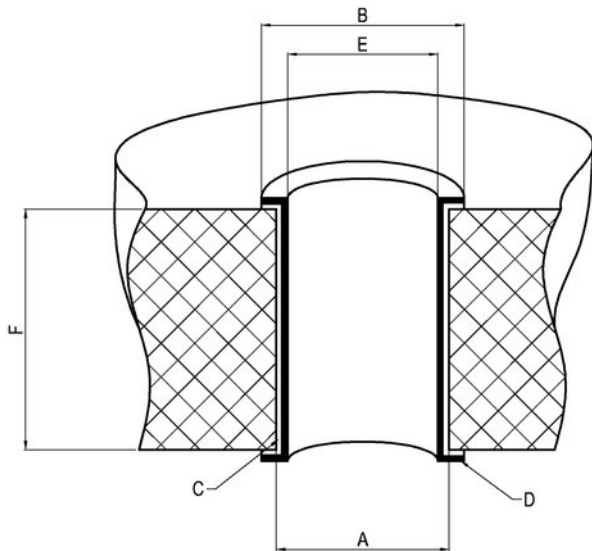
* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

PressFit Lochdefinitionen

PressFit Hole Definitions

Empfohlene Maße der Einpresszonen unserer PressFit Stift- und Buchsenleisten

Recommended Dimensions of PressFit Through Holes



A	Bohrungs-Ø	Base Hole Ø
B	Ring-Ø	Ring Ø
C	Cu-Schicht	Cu Layer
D	Veredelung	Plating
E	Endloch-Ø	Final Hole Ø
F	Leiterplattendicke	PCB Thickness

Serie Series	RM / Pitch [mm]	A [mm]	B [mm]	C [µm]	D Option [µm]		E [mm]	F [mm]
					Sn	Au/Ni		
TC-1886S TC-1888S	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05–0,2 Au 2,5–5 Ni	1,00 ^{+0,09} _{-0,06}	min. 1,60
TC-0628PF	2,00	0,89±0,03	min. 1,30	min. 30	max. 1,5 Sn	0,05–0,2 Au 2,5–5 Ni	0,81±0,05	min. 1,60
TC-0306PF	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	5–15 Sn	0,05–0,2 Au 2,5–5 Ni	1,00 ^{+0,09} _{-0,06}	min. 1,60
TC-0306PF	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	5–15 Sn	0,05–0,2 Au 2,5–5 Ni	1,00 ^{+0,09} _{-0,06}	min. 2,50